

公司代码：600584

公司简称：长电科技

江苏长电科技股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长电科技	600584	G苏长电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宏鲲	袁 燕
办公地址	江苏省江阴市滨江中路275号	江苏省江阴市滨江中路275号
电话	0510-86856061	0510-86856061
电子信箱	IR@jcetglobal.com	IR@jcetglobal.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务、经营模式

长电科技提供微系统集成封装测试一站式服务，包含集成电路的设计与特性仿真、晶圆中道封装及测试、系统级封装及测试服务；产品技术主要应用于 5G 通讯网络、智能移动终端、汽车电子、大数据中心与存储、人工智能与工业自动化控制等电子整机和智能化领域。目前公司产品技术主要涵盖 QFN/DFN、BGA/LGA、fcBGA/LGA、FCOL、SiP、WLCSP、Bumping、MEMS、Fan-out eWLB、POP、PiP 及传统封装 SOP、SOT、DIP、TO 等多个系列。

（二）行业情况

公司所属行业为半导体封装测试行业，半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于通信类、消费类、高性能计算等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路制造和封装测试三个子行业。

1、全球半导体市场情况

由于受全球新型冠状病毒疫情影响，IMF 预计 2020 年全球 GDP 将萎缩 3%，假设疫情在 2020 年下半年消退，防控措施可以逐步取消，在这一情景中，随着政策支持措施帮助经济活动恢复正常，全球经济预计在 2021 年将增长 5.8%。市场调查机构 Gartner 公布的最新研报，2019 年全球半导体营收共计 4,191 亿美元，较 2018 年下降 12%。IC Insights 预测 2020 年全球集成电路市场收入为 3,458 亿美元，增长率为-4%。但随着疫情的逐步缓解，5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和广泛应用，将带动相关行业的复苏和迅速发展。

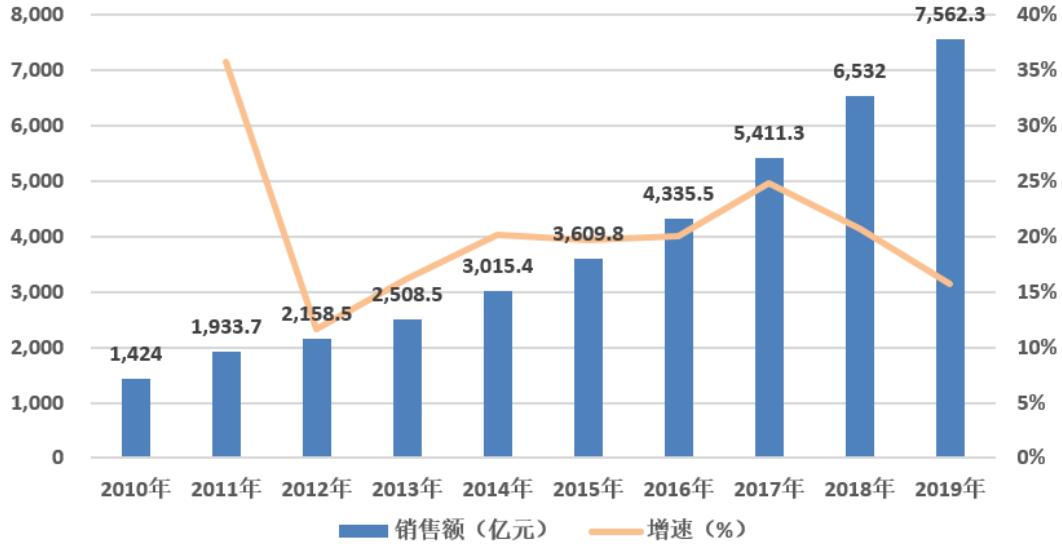
目前亚洲仍为全球最大的半导体市场，以中国为代表的亚太市场经济发展迅速。智能电子产品渗透到生活中的方方面面；5G 时代促使行业快速发展，带动 5G 通讯网络、人工智能、汽车电子、智能移动终端的需求和技术不断发展升级；同时，大数据将成为新型战略资源，数据存储芯片需求不断增加。与此同时信息安全的挑战越来越大，对电子产品性能的各项要求提升速度加快，对材料和设备的基础研究需求越来越大。全球化的供应链已形成，中国已经成为全球半导体供应链中不可缺少的一环。

2、我国集成电路市场情况

中国是全球最大的电子产品生产基地，中国国内消费者消费能力提升，对产品品质的要求不断提升，国内领先品牌的电子产品受关注程度不断提高，带动相关芯片需求的增长。美国限制对华高端半导体技术、产品、设备出口，在一定时间内产能和技术受到一定影响。

近年来，在国家政策扶持以及市场应用带动下，中国集成电路产业保持快速增长，继续保持增速全球领先的势头。2019年我国集成电路销售收入达7,562.3亿元，同比增长15.8%。

中国集成电路行业销售额及增速



数据来源：中国半导体行业协会

3、 半导体行业上下游情况：

集成电路产业链包括集成电路设计、集成电路制造、封装与测试、装备材料行业。公司所属封装与测试位于产业链中下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。集成电路封测的客户是集成电路设计公司和系统集成商，设计公司设计出芯片方案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、测试，再由上述客户将封测好的产品销售给电子终端产品组装厂。

集成电路封装测试行业的供应商是装备和材料。封测的主要原材料为：芯片、基板、合金线、金线、引线框、塑封料、被动元件等，原材料的供应影响封测行业的生产，原材料价格的波动影响封测行业的成本。近年来我国集成电路封装测试行业的快速增长，也带动了集成电路支撑产业的发展，国产装备和材料的进口替代份额正在逐步增加。

集成电路封装测试行业是为集成电路设计公司提供微系统集成和芯片封测服务。设计公司及系统集成商根据消费市场的需求不断创新产品，同时新产品又创造了新的需求，拉动消费市场的增长。例如在当前5G、人工智能、云计算时代，5G智能终端、智能城市、智能家居、无人驾驶等产品和应用不断推陈出新，也促进半导体市场的不断发展。终端设备的智能化、功能多样化、轻薄小型化促使芯片封测技术不断向高密度、高速率、高散热、低功耗、低时延、低成本演进。集成电路设计拉动了半导体产业的技术进步和产品更新，而晶圆制造业、封测业及支撑业的技术进步又促进了集成电路设计业的发展，随着集成电路进入后摩尔时代，集成电路上下游产业链的协

同创新的作用显得更为突出和重要。

4、 封装测试子行业情况和行业竞争：

由于市场对于微型化、更强功能性及热电性能改善的需求提升，半导体封测技术的精密度、复杂度和定制性继续增强。该趋势导致众多集成电路制造商将封测业务外包给专门的封测外包企业，不仅有利于提升产品品质，同时还可以降低此资本密集度较高行业的资本支出。许多集成电路制造商还将封测外包企业作为获得封测新设计和先进互连技术的主要来源，同时借此降低内部研发成本，所以市场对于封测外包企业的技术和质量要求也越来越高。

集成电路封装技术的演进主要为了符合终端系统产品的需求，为配合系统产品多任务、小体积的发展趋势，集成电路封装技术的演进方向即为高密度、高脚位、薄型化、小型化。集成电路封装技术的发展可分为四个阶段，第一阶段：插孔原件时代；第二阶段：表面贴装时代；第三阶段：面积阵列封装时代；第四阶段：高密度系统级封装时代。目前，全球半导体封装的主流已经进入第四阶段，SiP， PoP, Hybrid 等主要封装技术已大规模生产，部分高端封装技术已向 Chiplet 产品应用发展。SiP 和 3D 是封装未来重要的发展趋势，但鉴于 3D 封装技术难度较大、成本较高，SiP， PoP， HyBrid 等封装仍是现阶段业界应用于高密度高性能系统级封装的主要技术。

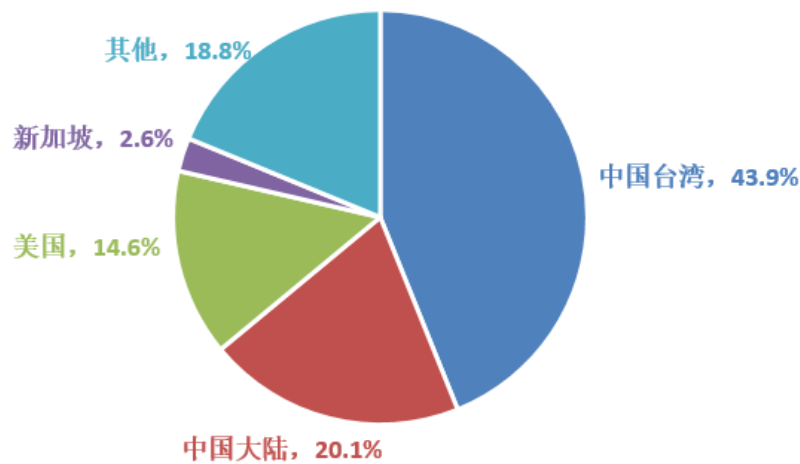
随着摩尔定律演进的技术难度和投资规模不断提高，半导体行业正越来越依赖于封装技术的发展。集成电路设计的复杂性和流片成本不断提高，微系统集成封装和系统组装的作用越来越大。随着半导体技术节点来到 5 纳米，在很多要求高性能高散热芯片设计中，封装设计中的低干扰、低功耗、高散热变得至关重要。集成电路和封装的协同设计已成为产品成功的关键。

近几年随着 5G 通讯网络、人工智能、汽车电子、智能移动终端、物联网的需求和技术不断发展，市场需求不断扩大，为国内封装企业提供良好的发展机会。根据 Yole 预测，到 2023 年，射频前端模块的 SiP 封装市场规模将达到 53 亿美元，复合增长率为 11.3%。根据 Accenture 预计，到 2026 年全球 5G 芯片市场规模将达到 224.1 亿美元。5G 时代的到来，将带动半导体产业的发展，推动 SiP 等先进封装的需求，成为先进封装领域新的增长动能。

最近几年，主要封测厂之间发生多起并购案，通过对并购公司的整合、消化、吸收，使得行业整体技术和水平得到了快速提升和发展。而从近几年市场份额排名来看，行业龙头企业占据了主要的市场份额，2019 年前三大企业市占率为 56.4%。

全球封测市场，中国台湾，中国大陆和美国占据主要市场份额，具体如下：

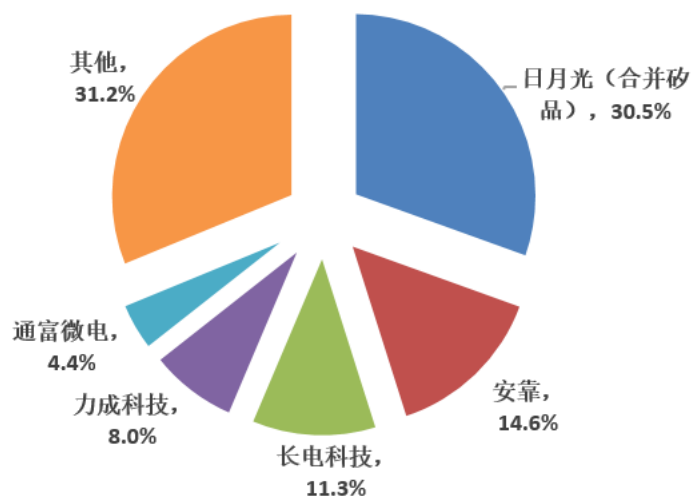
2019年全球集成电路封测行业所在区域市场占有率



资料来源：前瞻产业研究院整理

2019年全球前五大集成电路封测企业市场占有率具体如下：

2019年全球封测企业市场占有率



数据来源：芯思想研究院2019年12月发布的预估报告

中国半导体协会的数据显示，2019年我国集成电路封测收入为2,349.7亿元，同比增长7.1%。2019年，大陆封测企业数量已经超过了120家，市场规模从2012年的1,034亿元，增长至2019年的2,349.7亿元，复合增速为12.4%，增速低于集成电路整体增速。

长电科技2019年度销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三，境内第一，在品牌领导力、多元化团队、国际化运营、技术能力、品质保障能力、生产规模，运营效率等方面占有明显领先优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

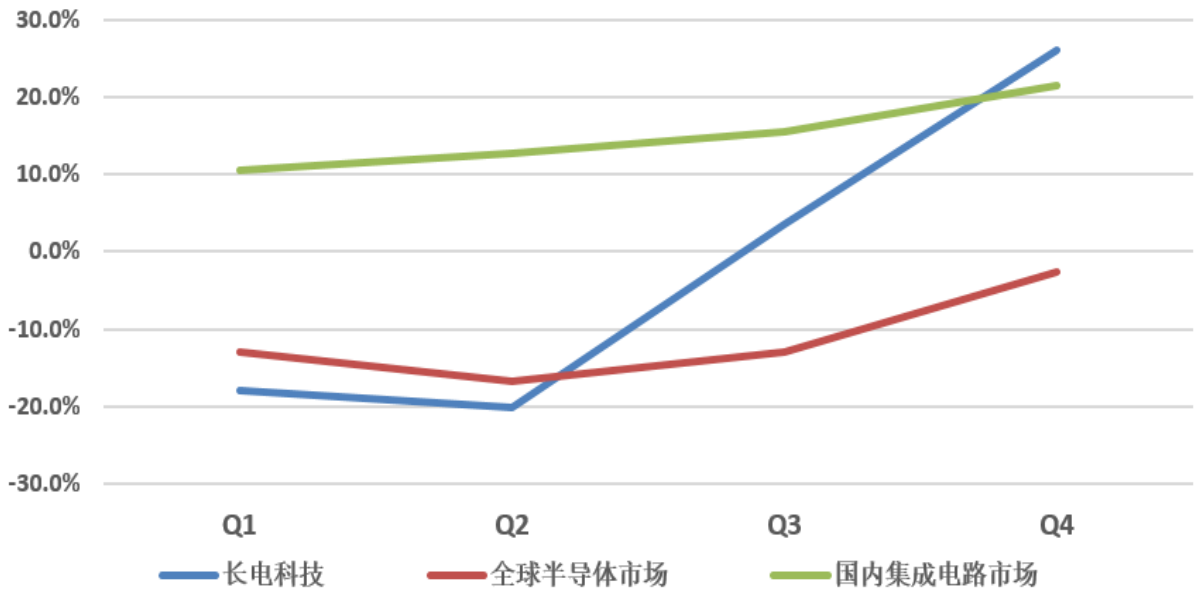
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	33,581,893,568.01	34,427,401,030.36	-2.46	30,698,704,663.05
营业收入	23,526,279,785.46	23,856,487,366.62	-1.38	23,855,512,379.95
归属于上市公司股东的净利润	88,663,437.59	-939,315,302.79	不适用	343,346,784.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-792,844,915.85	-1,308,604,096.29	不适用	-262,864,625.52
归属于上市公司股东的净资产	12,627,430,980.43	12,292,223,960.10	2.73	9,445,070,366.79
经营活动产生的现金流量净额	3,176,424,596.47	2,509,192,669.07	26.59	3,804,585,572.46
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.65	不适用	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.65	不适用	0.28
加权平均净资产收益率（%）	0.71	-9.15	不适用	4.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	4,514,773,490.97	4,633,688,075.11	7,047,485,231.13	7,330,332,988.25
归属于上市公司股东的净利润	-46,516,845.29	-212,381,706.06	77,020,170.01	270,541,818.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-167,825,972.95	-255,486,488.16	43,053,242.27	-412,585,697.01
经营活动产生的现金流量净额	169,193,210.11	647,884,490.37	545,359,813.88	1,813,987,082.11

公司及行业市场2019年度分季度营收同比变化



数据来源: WSTS、中国半导体行业

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数 (户)	119,983						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	170,729						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	304,546,165	19.00	304,546,165	无		国有法人
芯电半导体(上海)有限公司	0	228,833,996	14.28	228,833,996	无		境内非国有法人
江苏新潮科技集团有限公司	-119,124,252	47,954,732	2.99	0	无		境内非国有法人
无锡金投领航产业升级并购投资企业	0	33,579,583	2.09	33,579,583	无		境内非国有法人

(有限合伙)							
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	31,363,300	1.96	0	未知		未知
前海人寿保险股份 有限公司一分红保 险产品华泰组合	20,610,410	20,610,410	1.29	0	未知		未知
香港中央结算有限 公司	-9,114,229	20,109,537	1.25	0	未知		未知
中国工商银行股份 有限公司一广发双 擎升级混合型证券 投资基金	15,569,176	15,569,176	0.97	0	未知		未知
中国工商银行股份 有限公司一广发创 新升级灵活配置混 合型证券投资基金	12,700,481	12,700,481	0.79	0	未知		未知
上海高毅资产管理 合伙企业(有限合 伙)一高毅邻山1号 远望基金	11,589,000	11,589,000	0.72	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无实际控制人，前两大股东分别为：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司，前两大股东之间不存在任何一致行动关系，其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，受国际贸易摩擦以及全球半导体产业周期的影响，整体行业波动较大，呈前低后高

的态势。同时，公司完成了董事会、监事会的换届选举以及管理层的选聘工作，进一步强化了公司经营团队的国际化管理能力。

报告期公司管理层在董事会的带领下，攻坚克难，深化整合，持续拓展业务，不断强化管理，积极推进创新，整合内部资源，优化全球价值链，不断提升公司经营管理水平，实现扭亏为盈。2019年公司归属于上市公司股东的净利润为0.89亿元，上年同期为-9.39亿元。公司财务结构得到改善，负债率下降1.9个百分点。

（1）强化技术创新，储备先进封测技术

公司紧跟客户需求，强化技术创新，持续保持封测技术的领先，2019年长电科技市场占有率11.3%（资料来源：芯思想），排名全球OSAT（外包封测厂商）营收第三。长电科技具备完成所有先进封装类型产品以及全系列封装技术的能力，包括FC（Flip Chip 高密度倒装），WLP（晶圆级芯片封装），SiP（系统级芯片封装）等。2019年度共新申请专利技术158项，获得国家集成电路封装测试产业链技术创新战略联盟创新技术成果奖。

2019年，长电江阴集成电路事业中心在高端SiP项目，与国内外重大客户达成深度合作，在超大颗QFN（大于10x10）形成专利优势，抢占安防、TV应用。长电滁州HFBP（自主性封装）系列新产品开发项目已经完成预量产。长电宿迁新产品量产转化率实现42.5%，高于既定目标40%；在PDFN，T0-220等封装上实现铝带替代铜线，降低制造成本25%。长电先进开发成功了FI ECP01005技术，实现了业内最小、最薄的包覆型WLCSP封装。星科金朋江阴厂成功导入国内重点战略客户FC倒装研发项目，及大尺寸（65x65，7nm）先进封装研发项目。

（2）注重质量为本，提高质量管理水平

公司在质量管理方面持续贯彻“做强长电，质量为本”的理念，广泛开展质量文化年系列活动，包括“质量征文比赛”、“质量培训汇报”、“质量重大项目跟踪”等贯穿全年的活动。通过活动的开展，营造全方位、全员抓质量的良好氛围，全面提高了公司质量管理水平，产品良率和可靠性均达客户目标，客户投诉件数持续降低，较2018年下降19%。2019年中国区工厂有3个六西格玛课题参加江苏省统计技术学会的交流，获得了2个一等奖和1个三等奖。依靠过硬的产品质量与技术服务，2019年公司被国内外多家重点客户授予最佳供应商，得到了客户和市场的广泛认可。

（3）精简组织架构，提升管理效率

2019年积极推动组织变更、管理扁平化，撤除原星科金朋总部，保留必要职能部门，并入工厂或集团总部，精简组织架构。同时，公司新建供应链，精益生产，应用技术服务等集团总部功

能，强化总部研发功能，以此减少组织层次重叠，加快信息流的速度，提高决策效率。

(4) 加强人才队伍的培养与建设

公司在人才建设和培养方面，以高层次、高技能人才为重点，统筹完善各类人才队伍的建设，坚持以内部培养晋升、外部吸收引进相结合的方式，使公司的储备人才队伍持续壮大，为公司可持续发展奠定基础。2019年公司和多个学校签订校企协议，保障企业用工“量”和“质”的要求；在2019年的校园招聘中，设置管理培训生，进行多点轮岗制，为长电可持续性发展储备优秀人才。随着新的领导团队的加入，初步形成公司的国际化的经营团队，充分利用上海总部的优势，对标长三角一体化和国际化。

(5) 加强理念与文化建设，提升公司凝聚力

公司结合半导体行业特点及员工结构，加强了公司的理念与文化建设，致力于形成简洁高效、结果导向、准备充分、知正行端的工作作风，提升公司的凝聚力。同时，公司组织开展了多种形式的企业文化建设活动，“长电文化艺术节”、“长电体育比赛”等，营造积极向上、健康和谐的企业氛围，进一步强化团队的合作意识。

主要财务数据变动分析表

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	23,526,279,785.46	23,856,487,366.62	-1.38	/
营业成本	20,895,116,352.45	21,130,758,310.68	-1.12	/
销售费用	264,828,644.36	285,371,372.61	-7.20	/
管理费用	1,043,776,803.88	1,110,520,305.93	-6.01	/
研发费用	968,754,249.66	888,385,192.40	9.05	/
财务费用	870,112,601.50	1,131,025,122.06	-23.07	/
经营活动产生的现金流量净额	3,176,424,596.47	2,509,192,669.07	26.59	/
投资活动产生的现金流量净额	-2,610,458,095.73	-3,555,857,298.25	不适用	/
筹资活动产生的现金流量净额	-2,938,891,968.90	3,421,880,571.39	不适用	主要系本期归还银行及其他金融机构负债相对较多
其他收益	296,061,195.13	154,847,121.45	91.20	主要系本年补助收益较上年同期增加
投资收益	6,828,037.45	452,297,019.16	-98.49	主要系上期转让新顺微、深长电股权投资收益较高
净敞口套期收益	-13,428,960.03	0.00	不适用	主要系会计政策变更重分类

公允价值变动收益	-86,233,054.18	-123,367,191.19	不适用	主要系台星科最低采购承诺价值变动
信用减值损失	-34,827,911.59	0.00	不适用	主要系会计政策变更重分类
资产减值损失	-233,928,751.44	-546,919,999.29	不适用	主要系本期计提商誉及长期资产减值损失减少
资产处置收益	743,480,368.26	-5,200,932.93	不适用	主要系本年以无形资产投资参股长电（绍兴）产生的资产处置收益
营业外收入	6,240,343.02	9,863,684.62	-36.73	主要系各项其他收入同比减少
营业外支出	50,846,499.16	19,020,577.91	167.32	主要系本期资产报废损失较高
所得税费用	-16,277,413.42	113,644,871.50	不适用	主要系上期转让新顺微、深长电股权应交所得税较高
归属于母公司股东的净利润	88,663,437.59	-939,315,302.79	不适用	主要系报告期财务费用、资产减值损失减少及资产处置收益增加
少数股东损益	7,984,293.02	12,674,805.56	-37.01	主要系报告期子公司实现的少数股东损益增加
其他综合收益的税后净额	156,601,051.39	226,297,220.02	-30.80	主要系汇率变动影响外币报表折算差异
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.65	不适用	主要系报告期财务费用、资产减值损失减少及资产处置收益增加
收到的税费返还	651,451,339.42	317,543,293.11	105.15	主要系增值税退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	395,958,810.94	226,230,952.74	75.02	主要系收到补助增加
支付的各项税费	252,464,256.86	441,552,824.15	-42.82	主要系各项税费支付同比减少
收回投资收到的现金	72,742,469.17	1,550,655,559.36	-95.31	主要系上期收回理财产品的本金较多
取得投资收益收到的现金	32,486,410.68	7,248,389.49	348.19	主要系收到新顺微电子、深长电的分红款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	574,172,809.98	不适用	主要系上期收到股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	288,050,846.49	-93.06	主要系本期收到上海厂搬迁最后一笔补偿款，较上年同期同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,803,587,529.88	4,311,127,824.46	-34.97	主要系本期投资款支付相对减少较多

投资支付的现金	0.00	1,714,569,354.51	不适用	主要系上期有对外投资及投资理财
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	20,788,047.49	不适用	主要系上年同期收购达仕股权
吸收投资收到的现金	0.00	3,599,324,919.28	不适用	主要系上年同期收到募集资金
取得借款收到的现金	14,280,102,227.20	10,144,543,666.76	40.77	主要系本期银行短期借款筹资增加
收到其他与筹资活动有关的现金	2,117,868,426.98	0.00	不适用	主要系本期增加融资租赁筹资
偿还债务支付的现金	17,300,176,448.99	8,015,300,137.16	115.84	主要系本期提前赎回 4.25 亿美元优先票据、归还银团贷款 2.46 亿美元以及其他到期银行债务的归还
汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,131,026.17	91,498,868.57	-64.88	主要系本期汇率变化

资产负债表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,569,393,396.00	7.65	4,774,269,922.92	13.87	-46.18	主要系2019年1月提前赎回星科金朋4.25亿美元优先票据
衍生金融资产	4,119,413.24	0.01	1,922,363.72	0.01	114.29	主要系星科金朋发生的远期结售汇交易
应收票据	0.00	0.00	91,323,124.65	0.27	不适用	主要系会计政策变更所致
应收款项融资	67,584,630.96	0.20	0.00	0.00	不适用	主要系会计政策变更所致
其他应收款	10,944,727.48	0.03	151,613,133.40	0.44	-92.78	主要系本期收到新顺微、深长电分红款及股权转让款

可供出售金融资产	0.00	0.00	405,909,682.09	1.18	不适用	主要系会计政策变更所致
长期股权投资	971,660,594.36	2.89	190,369,225.77	0.55	410.41	主要系本期投资参股长电（绍兴）
其他权益工具投资	517,049,881.56	1.54	0.00	0.00	不适用	主要系会计政策变更所致
在建工程	1,664,082,709.03	4.96	3,453,861,241.82	10.03	-51.82	主要系本期新增投资减少及结转固定资产
长期待摊费用	1,256,235.80	0.00	772,851.48	0.00	62.55	主要系摊销余额增加
递延所得税资产	128,106,315.77	0.38	83,600,496.22	0.24	53.24	主要系可抵扣亏损导致产生的递延所得税增加
其他非流动资产	934,907.57	0.00	137,150,377.86	0.40	-99.32	主要系重分类至流动资产
应付票据	958,145,682.25	2.85	650,097,598.13	1.89	47.38	主要系本期开具银行承兑汇票增加
应交税费	53,226,873.84	0.16	109,398,233.53	0.32	-51.35	主要系应付所得税减少
其他应付款	235,425,281.38	0.70	362,555,207.79	1.05	-35.06	主要系会计政策变更报表项目重分类所致及其他应付款项减少
一年内到期的非流动负债	1,826,772,611.88	5.44	5,280,194,159.04	15.34	-65.40	主要系提前赎回4.25亿美元优先票据及提前归还银团贷款2.46亿美元
长期借款	1,584,384,891.47	4.72	2,933,790,044.10	8.52	-46.00	主要系1年内到期长期借款转入流动负债
长期应付款	1,215,622,628.92	3.62	329,090,257.01	0.96	269.39	主要系增加融资租赁
长期应付职工薪酬	1,405,672.34	0.00	815,921.74	0.00	72.28	主要系韩国子公司设定收益计划价值变动
其他非流动负债	0.00	0.00	28,904,903.75	0.08	不适用	主要系对台星科最低采购承诺转至流动负债
其他综合收益	428,946,927.71	1.28	181,944,546.61	0.53	135.76	主要系外币财务报表折算差额及权益工具价值变动
未分配利润	231,285,970.34	0.69	142,622,532.75	0.41	62.17	主要系报告期盈利
少数股东权益	10,924,415.93	0.03	2,940,122.91	0.01	271.56	主要系报告期子公司实现的少数股东损益增加

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更（1）

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

会计政策变更（2）

2019 年，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求已执行新金融准则的企业按照通知要求编制 2019 年度财务报表。公司自 2019 年 1 月 1 日起相应调整了财务报表相关项目的列报。

上述具体变更内容及影响详见《江苏长电科技股份有限公司 2019 年年度报告》第十一节、财务报告 五、重要的会计政策及会计估计之“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见 2019 年年度报告全文附注八。

江苏长电科技股份有限公司

董事长：周子学

二〇二〇年四月二十八日